

2021年3月期 中計進捗説明会 質疑応答

参考資料:2021年3月期 中計進捗説明会資料

[https://www.mitsui-](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=DMqMMJMC4Xc%3d&tabid=100&mid=826&TabModule819=0)

[kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=DMqMMJMC4Xc%3d&tabid=100&mid=826&TabModule819=0](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=DMqMMJMC4Xc%3d&tabid=100&mid=826&TabModule819=0)

(補足) PKG : パッケージ基板

HDI (High Density Interconnect) : マザーボードに使われる高密度実装基板

L/S (Line & Space) : 回路の線幅の細さおよび回路間のスペース

Q. 機能材料が中計のターゲットに対して下振れの傾向であるという解説でしたが、主力製品の銅箔、銅粉および ITO に関して、原因をマーケット要因、自責に分けて、それぞれ何が悪くてダメだったかということとそれらの対策についてもご解説いただけますでしょうか。

A. 銅箔の HDI 向けの MicroThin™について、これは自責の問題はまったくありません。当社は前広に生産設備を用意していましたが、残念ながら韓国・米国市場のお客様しか広がらなかったということが一番の原因となります。その理由は、MicroThin™を使わない製法でできる限界を L/S=30/30 と考えておりますが、現状の中華系のスマホはそれより少しラフピッチで造るなど、当初の予定から少し読み違えたところがあります。ただ、5G スマホになると搭載する部品点数が増えるため、本格的な 5G スマホが出てから、ファインピッチ化が進むかどうか、もう一度見極めたいと思っております。

PKG 向け MicroThin™は市場の伸びも想定通りであり、当社のシェアも足元、ほぼ 100%に近いので全く問題ありません。PKG 向けは市場が成長していく中で、キャパのご心配があったかと思いますが、マレーシアで十分に PKG 向けも作れますので、こちらについては何の心配もしていません。

銅粉については、世の中で MLCC が急激に伸びるという話があり、アトマイズ粉を神岡と下関で増産する計画でしたが、これは当社だけでなく、市場の方も読み間違えたという面がありました。ただ、今後は増えていく傾向にありますので、19 中計で予定していた増産が 22 中計に延びるものと思っております。

ITO は、トップシェアだったため、シェアを維持し、さらに広げていくコストリーダーシップ戦略をイメージし、価格を安くしてシェアを取っていくと考えましたが、中国競合もそれなりのレベルのものが出来るようになり、市場環境が大きく変わったということがあります。このような状況の中で、収益重視でマージンを高く取れるお客様に絞って事業を継続していきます。韓国の拠点は、閉鎖することに決めましたので、今後は ITO についてもそれほど大きな問題はなく、今の事業計画の延長上で行けると思っております。

Q. 金属市況の変動に対して大きな業績のボラティリティが出てきているのは、例えば22ページ目で説明されている製錬ネットワークにより、金属のリサイクルによる影響が大きくなったこともあるのでしょうか。以前はこんなにブレなかったと思いますので、ご解説いただければと思います。

A. 今回、特に金属市況の影響を受けたのが、先ほど少し問題児に近づいてきたという説明をした触媒です。ロジウムを使うものが四輪触媒で非常に多く、今まで以上に貴金属の価格高騰についての管理を、生産管理や物流を含めて進めないといけないと思っております。もう一つは日比製錬所の銅製錬で出てくる貴金属についても実収差量が非常に多かったため、金属市況の影響が強く出ております。

- Q. PKG向けのMicroThin™の今後の数量の伸びについて、スマホ・非スマホ向けでどれくらい見られているのか、向こう2～3年くらいのイメージを教えてください。
- A. スマホ向けでは、5GアンテナモジュールやRFモジュールなど、5Gのスマホが増えていくことで1台に搭載される部品点数も増えることから、数量の伸びを見込んでおります。非スマホ向けは、サーバー用のSSD(Solid State Drive)などのパッケージやその他の色々なパッケージ用途が増えております。
今年度は、昨年度のトータル数量から10%増としております。それ以降につきましては、今まさに次の中計の準備として、お客様を含め色々と調査を進めている段階にあり、この場では控えめですが、少なくとも増えていくことは間違いないと自信を持って言えます。
- Q. 全固体電池について、車載向けが2020年代の後半というお話しでしたが、以前は2022～2025年と仰っていたと思いますが、変わった背景を教えてください。
- A. 車載向けが2022～2025年という話しは確かにありましたが、お客様を含めやはりハードルがかなり高いということが一つ。もう一つは液系のリチウムイオンバッテリーを各社が増産されていることから、やはり液系と明らかに違う特性を出すところまで研究を進めていくことが必要という認識でおります。そのため、量産については国内外の自動車メーカー各社とも2020年代の後半、と同じようなタイミングで言われています。
- Q. 最近カーボンニュートラルの話をされる会社が非常に多いが、御社はどのようなお考えなのか教えてください。
- A. 当社のCO2排出量は金属部門が約65%を占めており、その中でも八戸製錬が、かなりのボリュームになっています。これについては、環境省のTCFDシナリオ分析支援事業に参加しており、環境省のHPに当社のことが掲載されております。それを含めて全社でもう一度検討し、どこかのタイミングで開示できるように進めております。
2050年のカーボンニュートラルの実現は避けられません。その前段階として、現在、当社としては2030年で2013年度比26%の削減は完全に射程に入っておりますが、さらに上積みを検討している段階にあり、タイミングを見てまたご説明させていただきます。
- Q. 触媒の事業について、もともとMicroThin™などと同じく成長が期待されていた事業だと思うのですが、今回問題児のような感じに扱われているのが、少し残念な感じがします。需要の拡大の見通しについて、当初の想定と何か乖離があるのかどうかを教えてください。
- A. 「問題児」が適切な表現かどうか分かりませんが、ROICで見てもどうかということ。四輪触媒ではロジウムを多く使うため、投下資本が大きくなってきて中で、利益は上がっているが効率性やボラティリティの点から、要注意という意味合いで申しました。
拡販につきましてはCOVID-19の影響を除くと二輪、四輪とも全く問題なく、当初の計画通りとご理解いただいて良いと思います。また、二輪、四輪とも開発で次の車種に採用される点は問題ないことから、事業運営上は全く問題ありません。

- Q. 触媒については、ロジウムを多く使う四輪触媒のボラティリティが高いことと、投下資本が膨らむというこの2点が、企業価値を損なうという問題意識をお持ちということですか。
- A. 触媒は二輪触媒が中心であった時は非常にROICが高かった。ロジウムの高騰もあるが、四輪触媒の増加に伴いROICは下がる。収益は上がっているが、効率性は少し下がっていくことは、ボラティリティとともに問題と思っております。
- これは私の考えであります。ホンダさんが2040年にエンジン搭載車をやめる。車の寿命が大体10年程度であり、2040年に変えると2050年のカーボンニュートラルにマッチすることから、2040年には当社の主力であるホンダさんの触媒は、恐らく無くなると思っております。2040年までにまだ時間はありますが、触媒事業の効率的な運用をどのように行うかについて、他の機能材料とは少し違った考え方を持つ必要があると考え始めております。
- Q. 銅鉱山事業から撤退して、銅製錬に特化するという説明がありましたが、銅の製錬事業における御社の強みを教えてください。
- A. 日比の銅製錬としては、銅や貴金属を含むリサイクル原料を上手く使っていく点です。そのため、今までどおり原料購入と製品販売はPPCと一緒に進んでいく中では、銅鉱山は当社にとって魅力も意味もあまりないことから、銅事業は製錬に特化していきます。日比製錬所は当社が昔から経営を行っているため、勘どころや設備の肝をよく知っており、効率的な操業による効果が非常に大きいと思っております。
- Q. 金属セグメントの製錬ネットワークについて、これを活かした上でどのようなシナジーが期待できるかを、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
- A. 亜鉛、鉛の製錬では、銅や貴金属が微量ながら入っており、銅製錬の中にも亜鉛や鉛の不純物が入っております。亜鉛と鉛と銅の3つと、あとは串木野にある貴金属工程、この4つを全て持っているのは当社くらいであり、それらを上手くネットワーク化させることで、社外に出さずに、自分たちで全て回収することが出来る。これは非常に大きな強みであり、さらに新しい技術を導入して、より効率的に実現できるように検討しております。
- Q. 銅箔の今後の戦略について、中計進捗説明会資料P16でHDI向け MicroThin™については、次期中計にて見極めると記載されておりますが、この見極めというのはどのような方向性なのかを確認させて下さい。また、今回、投資も行って効率化を進めることから、上方弾力性への対処を行われると思うのですが、今後の銅箔のキャパについてどのように考えているのか、全体感として教えていただければと思います。
- A. ファインピッチ化が進むかどうかHDI向け MicroThin™拡販の一番のポイントだと思っております。今後出てくるミリ波対応の5Gスマホが、本格的な5Gになったときに、どのような回路設計になるのか見ていきたいと思っております。
- MicroThin™のキャパシティですが、マレーシアが月産240万㎡で、上尾を含めると月産400万㎡近くある。次の中計期間中では、いきなりPKG向けが月産400万㎡に近いところまで伸びることは考えにくいので、マレーシアにある4台のMicroThin™の設備の1台をハイエンド電解銅箔用にいったん切り替えておく。マレーシアも、PKG向けが生産出来るようになっており、この3台でPKG向けが増えても大丈夫だと考えております。

- Q. フリーキャッシュフローが中計の合計では少し届いていないという説明がありましたが、安定度を高める観点から投資や償却のバランス、今後の成長のための経営資源の配分について、納社長としてはどのような方向性を考えられているのか教えてください。
- A. 自己資本比率 40%を目指していることは、リーマンショックのようなことが起きた際の安定性を考えると、必要だと思っております。次期中計を考える中で、どのような財務戦略にするかは、極めて重要だと思っております。
- 既存の事業で生まれてくるキャッシュを次の新規事業に回すことを、遅らせることなく実施していくべきであると考えており、財務規律とともに、次にどのような投資案件があるか、しっかり議論していきたいと思っております。
- Q. MicroThin™の今期の見通しについて、販売量は 10%増えるが、利益は開発費や様々なコストが出てくるため、微増益に留まると計画されています。PKG 向けが伸びていく中で、コストのコントロールに関して、今後どのように考えていくのかを、もし対策があれば教えてください。
- A. 上尾の MicroThin™とマレーシアの MicroThin™はともに同じ PKG 向けで使われることから、今、生産移管の展開をしています。マレーシアの方がコストが安いことから、お客様の都合を勘案しながら出来るだけマレーシアに移管することが、マージンアップにつながっていくと考えており、それを進めていきたい。
- もう一つは、MicroThin™の次世代製品を開発してマージンアップさせていく。今後、高周波向けの MicroThin™ (MT-GN) を伸ばしていきたいと思っております。
- Q. 新社長から見た御社の問題点や課題をどう解決していきたいか、また銅鉦山のように今後撤退する事業の有無について教えてください。
- A. 当社は皆様から「何の会社なの」と言われることが多いです。当社は、注力していくところが、なかなか分かりづらいことから、最後に説明した「今後の経営について」の①パーパス(存在意義)として、今しっかり議論しております。その中で、このパーパスに沿っていない、あるいは別にベストオーナーがいるのではないかという事業や製品、会社があるかどうかをしっかりと見て、今後のポートフォリオを考えていきたいと思っております。少なくとも当社としては、マテリアルの知恵を活かしながら、世の中の人々を豊かにしていく製品を作っていく、これは間違いなく狙っていききたいところではあります。
- 昨年の 7 月から次の中計を検討するチームリーダーを私が務めており、先ほど説明したパーパスをどうするかという議論を行っています。その中で、次の 22 中計の時には、当社はどのような会社なのか、何を目指しているのかを説明できるようにしたいと思っております。

以上